



# CP シリーズ 熱伝導絶縁キャップ

## 製品特長

- ・ 低熱抵抗
- ・ 高絶縁性
- ・ 作業容易

## 応用範囲

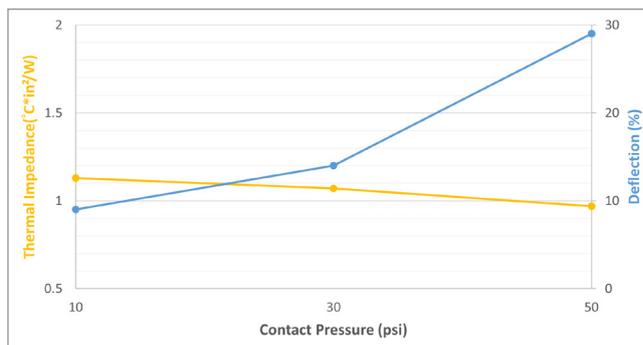
Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

## 標準サイズ一覧 (mm)

1. CP22 TO-220: 11.4x16x5.8
2. CP23 TO-220: 11.4x21.5x5.8
3. CP33 TO-247: 17.5x28.5x5.8

## 製品物性

## 圧力、熱抵抗、圧縮量



製品物性	単位	CP22/CP23/CP33	公差	試験基準
熱伝導率	W/m·K	2.0	±10%	ASTM D5470 Modified
厚さ	mm	0.45	-	ASTM D374
色	-	Gray	-	-
成分	-	Silicone	-	-
使用温度範囲	°C	-45~+180	-	-
密度	g/cm <sup>3</sup>	2.55	±5%	ASTM D792
耐電圧 (AC)	kV	>10	-	ASTM D149
耐電圧 (DC)	kV	≥6	-	ASTM D149
誘電率	1000Hz	5.8	-	ASTM D150
熱抵抗 @10psi	°C*in <sup>2</sup> / W	1.13	-	ASTM D5470 Modified
熱抵抗 @20psi	°C*in <sup>2</sup> / W	1.07	-	ASTM D5470 Modified
熱抵抗 @50psi	°C*in <sup>2</sup> / W	0.97	-	ASTM D5470 Modified
硬さ	Shore A	65	±7	ASTM D2240

## T-Global Technology 株式会社

〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー

T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version21  
20260226



注意：本技術からのデータ情報は T-Global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することをしません。製品の効能に影響を与えられない保護フィルムが剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望がなければ、T-Global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何か特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が T-Global とお互いに確認した invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。